

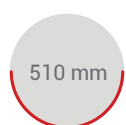
GAP-151P - Serie G6 SERVER RUGGED 1U

Intel® Xeon® Scalable

I/O Motherboard e Alimentatore Frontali



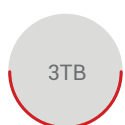
Piattaforma



Profondità



CPU



RAM



SSD



Schede I/O

GAP è una linea di server e workstation rugged realizzati in alluminio, progettati per applicazioni che richiedono un apparato robusto e qualificato, adatto a operare in ambienti critici.

I server rugged GAP-151P Serie G6 integra no singolo o doppio processore della serie Intel® Xeon® Scalable Processors (Skylake-SP / Cascade Lake-SP) che offre fino a 28 core e 56 thread, fino a 38.5 MB di cache L2, la nuova UPI (Ultra Path Interface), fino a sei canali di memoria, supporto AVX-512 e fino a 48 linee PCIe 3.0. I servizi di IPMI supportati consentono il controllo locale e remoto dei dispositivi integrati e permettono la segnalazione di allarmi e l'intervento immediato in caso di criticità.

GAP-151P è progettato per montaggio a rack 19", è caratterizzato da 1U di altezza e 510mm di profondità.

La configurazione con I/O motherboard e alimentatore frontali offre tutte le interfacce sul lato anteriore dello chassis per installazioni "front only".

I server rugged serie GAP-151P prevedono un SSD da 2.5" interno e possono integrare fino a due schede PCIe. Le schede aggiuntive possono essere provviste di sistemi di fissaggio dedicati per garantire il funzionamento ottimale anche in presenza di shock e vibrazioni o durante il trasporto.

I server rugged GAP sono conformi alle MIL-STD-810F per temperatura e shock, alle MIL-STD-167-1A per vibrazioni e opzionalmente alle normative MIL-STD-461. Su richiesta gli I/O e l'ingresso di alimentazione possono essere dotati di connettori MIL-GRADE.

Tutte le configurazioni sono accompagnate da inventory list per garantire il controllo della configurazione e la riproducibilità nel tempo. Su richiesta gli apparati integrati possono essere sottoposti a specifici profili di stress termico o meccanico.

CARATTERISTICHE

- Server Rugged 1U - 510mm profondità
- Singolo o doppio processore
- Intel® Xeon® Scalable
- I/O motherboard frontali
- Ingresso di alimentazione frontale
- Alimentatore Ridondato AC o DC
- 1 x SSD 2.5" interno
- Fino a 2 schede PCIe
- Conformal Coating opzionale
- MIL-STD-810G
- MIL-STD-461 opzionale

Specifiche Tecniche

Sistema

Processore	Famiglia Intel® Xeon® Scalable (fino a 205W TDP) - doppio socket P (LGA 3647) - Fino a 28 core
Memoria	Fino a 3TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933MHz Fino a 3TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz
Chipset	Intel® C621
Porte rete	2 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x RJ45 dedicata IPMI
Storage	2.5" SATA Disk - RAID 0, 1, 5, 10
TPM	1 TPM Header
I/O motherboard	Disponibili sul fronte: 1 x VGA, 4 x USB 3.0, 2 x GbE, 1 x IPMI
Schede aggiuntive	2 x schede PCIe - Bracket Full Height
Sistemi operativi	Windows® 8.1, Windows® 10 IoT Enterprise 2016, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 R2, Linux, VmWare
IPMI	IPMI2.0, SPM, Watchdog; notifica degli allarmi via SNMP ed e-mail
Monitoraggio remoto	Controllo delle funzionalità di sistema (velocità ventole, temperature, tensioni, alimentazione, consumi, stato dei dischi, stato delle memorie e della configurazione RAID)

Alimentazione

Alimentatore	100/240 VAC Ridonato 18-36 VDC Singolo o Ridonato 36-72 VDC Singolo o Ridonato
---------------------	--

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni	483 x 44,45 x 510 mm
Materiale	Alluminio con trattamento di passivazione superficiale
Colore	Silver
Alloggiamento	Chassis 1U per montaggio a rack 19" Guide telescopiche opzionali
Configurazione	I/O motherboard e alimentatore frontali
Pannello frontale	Led: Led Power ON e funzionalità HDD/SSD; Pulsanti: Power ON / OFF e System Reset
Baie Drive	1 x alloggiamento SSD 2.5" interno

Parametri Ambientali - (Design to meet)

Temperatura operativa	Standard: 0°C / +50°C Estesa: -20°C / +60°C (in funzione delle configurazioni)
Umidità operativa	Da 8% a 95% non-condensata (in funzione delle configurazioni)
Temperatura storage	-40°C / +70°C
Vibrazioni	MIL-STD-810G, Method 514.7, Cat 4 - Proc. I - 2.24 Grms, 5-500 Hz 60 min/axis for 3 axes
Shock operativo	MIL-STD-810G Proc. I Method 516.7 - 15g / 11ms - half sine
Shock trasporto	MIL-STD-810G Proc. II Method 516.7 - 30g / 9ms sawtooth
Certificazioni	Direttiva 2014/35/UE-LVD / Direttiva 2014/30/UE-EMC Direttiva 2011/65/UE - RoHS / Regolamento (EC) No 1907/2006 - REACH

I server e le workstation GAP sono progettati in conformità alle specifiche ambientali indicate. Alcuni parametri dipendono dalla configurazione. Gli apparati possono essere sottoposti a profili di prova dedicati.